

高压工艺 USB Type-C PD3.2 快充协议智能识别芯片

产品特征

- 兼容PD2.0、PD3.0协议
- CC耐压15V
- 封装, SOT23-6

产品概述

FS212DKP 属于速芯微 FSFC 系列, 芯片选择性的兼容主流的充电协议。芯片可以智能的识别插入的手机类型, 选择最为合适的协议应对手机快充需要。

FS212DKP 的 CC 耐压高达 15V, 提高了系统的可靠性。

FS212DKP 使用 SOT23-6 封装。

应用领域

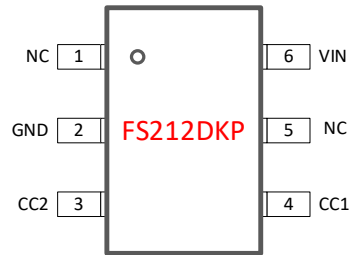
- 旅充
- 墙充
- 车充
- 插座
- 其他USB Type-A功率输出设备

订货信息

产品型号	封装形式	每盘数量
FS212DKP	SOT23-6	3000

V1.1(202603)

芯片封装和引脚定义



SOT23-6

图 1. 引脚定义

表1. FS212DKP引脚功能描述

引脚编号	引脚名称	描述
1	NC	悬空
2	GND	芯片地，连接到系统地
3	CC2	连接USB Type-C CC2引脚
4	CC1	连接USB Type-C CC1引脚
5	NC	悬空
6	VIN	芯片供电

极限工作范围

表2. 最大工作范围

参数	取值
VIN	-0.3V~5.5V
CC1/CC2	-0.3V~15V
ESD (HBM)	±2KV

上表所列最大工作范围，如果超过限制值，将可能永久损坏芯片。用户应该尽量避免。



正常工作范围

表 3. 正常工作范围

参数	取值
VIN	2.9V~4.5V
CC1、CC2	0V~3.3V
工作温度范围	-40°~105°
工作电流	<1mA

引脚定义和使用

VIN

VIN 为芯片供电，需要接 300Ω电阻上拉到 VBUS。
电容使用 1μF。

CC1 和 CC2

CC1/2 连接到 Type-C 口中的 CC1/CC2。



应用示例

FS212DKP 典型的应用如右图所示。

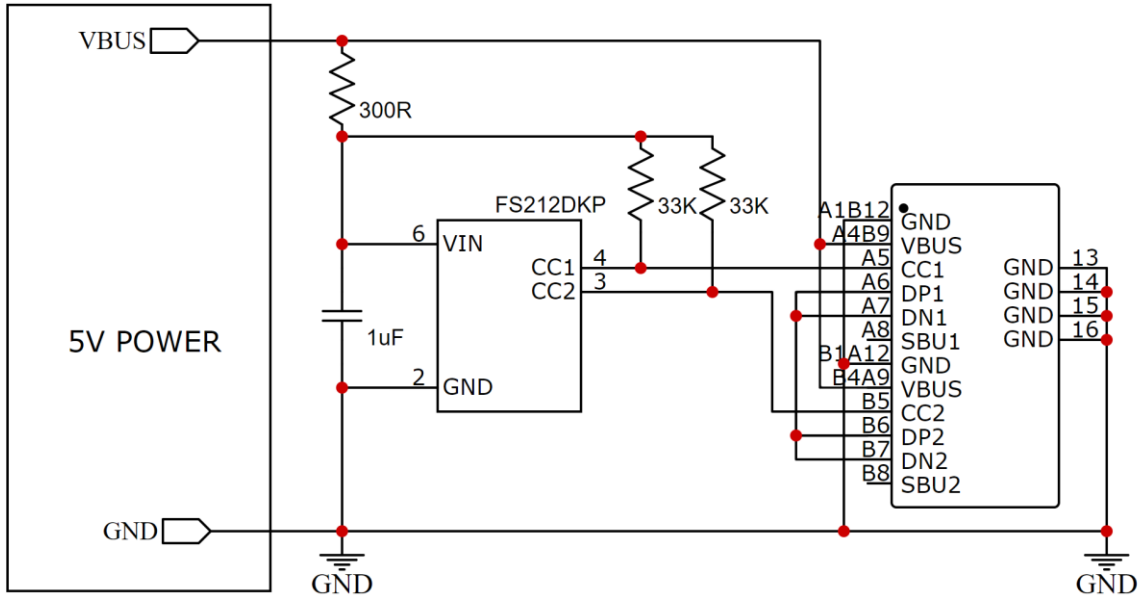
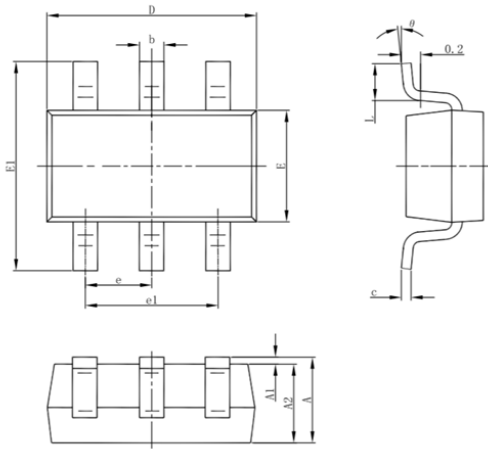


图2. 应用图



封装外形图

SOT23-6



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°



公司信息和声明

公司总部

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-503 室

网址: www.fastsoc.com

微信公众号: fastsoc

销售和技术支持

联系人: 葛小姐

电话: 1895-248-8621

邮箱: gejing@fastsoc.com

声明

无锡速芯微电子有限公司保留随时修改产品, 有权改变参数以及产品数据手册的权利。本文档所有信息, 包括产品的功能、性能等有可能在未告知用户的前提下修改。文中所描述的功能和性能指标在实验室环境下测试得到, 部分可以提供第三方测试报告, 但是不保证客户产品上能获得相同的数据。本文信息不提供任何形式的暗示、表明、支持、证明或者默认本产品可以用于侵犯第三方知识产权的应用。本文信息只作为芯片使用的指导, 不授权用户使用本公司或者其他公司的知识产权。

无锡速芯微电子有限公司的产品不针对极端条件以及生命支持系统设计。如果用户选择在这些场合应用, 在缺少我司确认和许可的情况下, 风险由用户自行承担。

无锡速芯微电子有限公司及其注册和使用的商标、标识、各类知识产权归属无锡速芯微电子有限公司所有。本文中使用的其他的商标、标识、设计、物料号等产权归属各自拥有者所有。